

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-steel-legend-wifi-am5-4ddr5-atx-p-349935.html>



Płyta główna B850 Steel Legend WiFi AM5 4DDR5 ATX

Cena brutto	834,99 zł
Cena netto	678,85 zł
Numer katalogowy	KBASRAA8B850A02
Kod producenta	B850 STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4711581490062
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2230/2260/2280
Interfejs sieciowy	LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	8000 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
RAID	Tak
Chipset	AMD B850
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	2 x Kabel danych SATA 2 x

	Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora
Maksymalna ilość urządzeń ATA	4
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	1 x Złącze przewodu termistora
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	11
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	9
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maks. wielkość pamięci	256
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC4082) Oddzielne warstwy PCB dla kanału audio R/L Technologia Direct Drive na przednim porcie słuchawkowym (obsługuje zestawy słuchawkowe do 600 Ohm) Nahimic Audio
Grafika	Zintegrowana karta graficzna AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora)- 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatybilny, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120 Hz
Rodzina procesora	AMD Ryzen 5

Opis produktu

B850 Steel Legend WiFi

Steel Legend reprezentuje filozoficzny stan solidnej jak skała trwałości i nieodpartej estetyki. Zbudowana wokół najbardziej wymagających specyfikacji i funkcji, seria Steel Legend jest skierowana do codziennych użytkowników i entuzjastów głównego nurtu! Zapewniając solidny zestaw materiałów/komponentów, aby zapewnić stabilną i niezawodną wydajność.

Ekskluzywny kondensator 20K o pojemności 1000uF

Ulepszony czarny kondensator 20K nie tylko wydłuża żywotność do 20 000 godzin, ale także zwiększa wartość pojemności z 560uF do 1000uF, co przynosi kilka korzyści:

- Większa pojemność: Większe magazynowanie ładunku dla lepszego wsparcia przy dużych obciążeniach.
- Niższe tętnienie: Zmniejszone wahania mocy wyjściowej, poprawa jakości.
- Bardziej stabilny prąd wyjściowy: Stabilne zasilanie, minimalizujące wpływ napięcia.
- Lepsza wydajność i stabilność systemu: Zwiększona niezawodność i stała wydajność.

14+2+1 Power Phase Design

Wyposażony w solidne komponenty i całkowicie płynne dostarczanie mocy do procesora. Ponadto oferuje niezrównane możliwości podkręcania i zwiększoną wydajność przy najniższej temperaturze, co jest również przydatne dla zaawansowanych graczy.

Dr. MOS

Dr.MOS to zintegrowane rozwiązanie stopnia mocy, które jest zoptymalizowane pod kątem synchronicznych zastosowań obniżających napięcie buck-set! W porównaniu do tradycyjnych dyskretnych tranzystorów MOSFET inteligentnie dostarcza wyższy prąd dla każdej fazy, zapewniając tym samym lepszy wynik termiczny i lepszą wydajność.

Złącze zasilania Hi-Density

Podkręcanie procesora wymaga wyższego prądu. Złącza zasilania ASRock Hi-Density są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać wyższe prądy w porównaniu do tradycyjnych złączy zasilania procesora i ATX, zapewniając bardziej stabilny system i zmniejszając ryzyko pożaru podczas intensywnego podkręcania.

Konstrukcja płytki PCB 8-warstwowej

Płytki PCB 8-warstwowa zapewnia stabilne ścieżki sygnału i kształty mocy, zapewniając niższą temperaturę i wyższą efektywność energetyczną, gwarantuje niezawodny i trwały system, zapewniając jednocześnie najwyższą wydajność bez żadnych kompromisów.

Obsługa DDR5 XMP i EXPO

Wywodząca się z koncepcji projektowania zbudowanego dla stabilności i niezawodności, ASRock nie idzie na żadne kompromisy w kwestii szczegółów. Ta płyta główna jest zbudowana z wysokiej jakości materiałów, entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością podkręcania pamięci DDR5, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci są zgodne z Intel XMP/AMD EXPO, a podkręcanie może być tak niedrogie, satysfakcjonujące i absolutnie bezproblemowe.

Złącze USB 3.2 Gen2x2 Type-C na przednim panelu

Najnowszy interfejs USB 3.2 Gen2x2 Type-C zapewnia prędkość przesyłu danych do 20 Gb/s, czyli dwa razy szybciej niż poprzednia generacja, zapewniając błyskawicznie szybki interfejs przesyłu danych z odwracalną konstrukcją USB Type-C, która pasuje do złącza w obie strony.